

全球唯一通過軍事聯盟認證的BGA/IC 零件拆/迴焊的設備

MARTIN[®]
Rework + Dispense Technic

BGA Engine MaFi-668

The most powerful BGA rework system

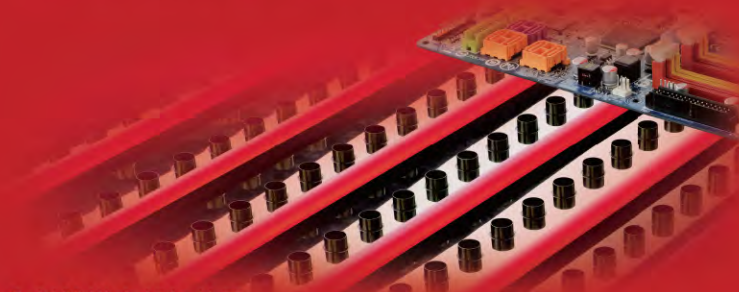
- ... Desoldering a BGA or CSP
- ... Removing old solder and residue
- ... Reballing a BGA or CSP
- ... Positioning and Placing a BGA or CSP
- ... BGA Soldering



MaFi-668 完美的完成BGA返修之任務, 任意類型不同尺寸大小的BGA / Filps chip甚或是QFN元件都能在極簡易且安全的操作下完成拆 / 迴焊搭載全新雙模底部加熱器後的 **MaFi-668** 不僅能輕易的達成BGA拆焊 / 迴焊同時也能輕鬆的完成除錫 / 植球等全方位返修工作的目標

- 獨一無二的視覺對位系統, 配合自動化置放系統造就了市場上精度最高的返修工作站系統

配合功能強大的雙模底部加熱器與高精準熱風系統, 使用專屬的真空除錫筆更可絲毫不傷Pads的將殘留錫清除一空



全新雙模底部加熱器

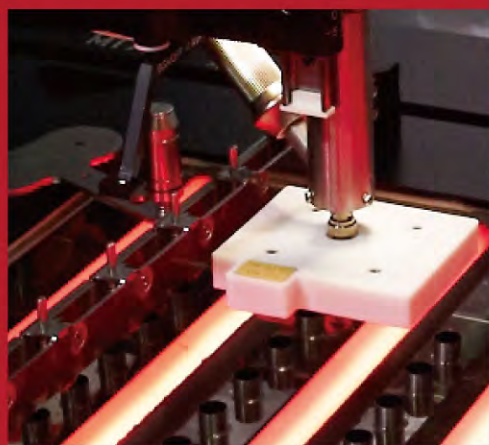
藉由簡單的點擊幾個功能按鈕強大的**視覺對位系統**即可自動的對BGA零件位置與角度做精確計算, 並藉由步進馬達系統將該元器件準確的自動置放於正確位置上。

BGA Engine MaFi-668

The most powerful BGA rework system



獨特的**底部支撐架**，能夠完美的記憶PCB底部高低起伏之高度差，如同記憶枕般提供PCB完美的支撐



功能強大的全新**雙模底部加熱器**，快速及時且非常均勻的提供底部預熱能量，PCB受熱就像在迴焊爐一般，保持最低PCB板彎扭曲量

Specification

Power Input	230 V / 50 Hz 25 A
Pressure Input	5.5~8 Bar
Hot air power output	10~250 W / 40 V
Hot air volume	2.0~35 L / Min
Hot air temp	150~400°C± 1%
Underheater power	1200~5000 W
Underheater size	420 x 450 mm
PCB size	500 x 600 mm
CCD camera resolution	1944 x 2595 pixel
Auto placement stroke	X-Y-Z / 75-75-40 mm
Auto placement angle	±10 °
CCD lighting	Ring type LED
PCB clipping	smart clip
PCB supporting	Flex Fix pin bar supporter (optional)
Weight	approx. 70 Kg
Communication Link	USB
Program software	Easy Solder
Thermo sensors	2 + 4
Hot air nozzle	CSP 4 pieces (covering all specs) optional
(all nozzles are optional)	BGA15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 23 / 25 / 27 / 29 / 31 / 32 / 33 / 35 / 37.5 / 40 / 40.5 / 45 / 46mm... Socket 478B / 775 / 1207 / 1165 / 1366 / 1567

TekServe[®] 欣岩企業有限公司

221新北市汐止區新台五路一段102號5樓

TEL: +886-2-2641738

http://www.tekserve.com.tw

E-Mail: info@tekserve.com.tw